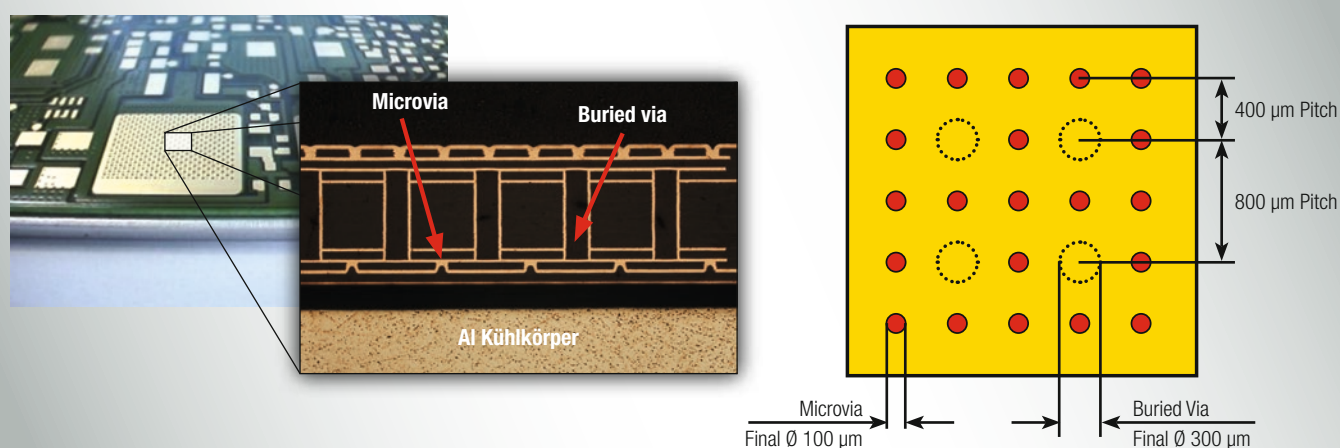
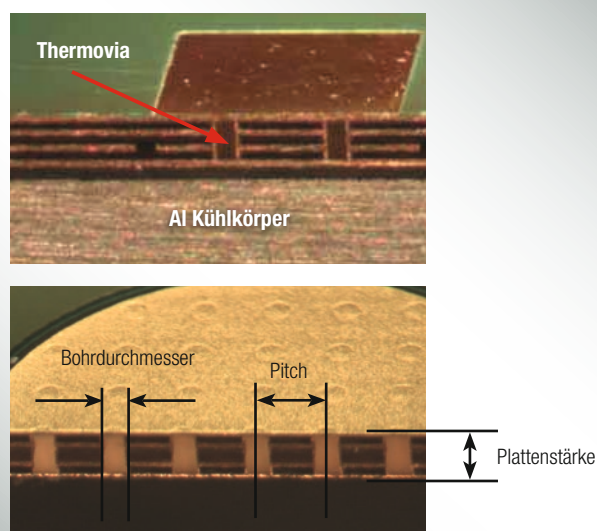


# Wärmemanagement Design Guide

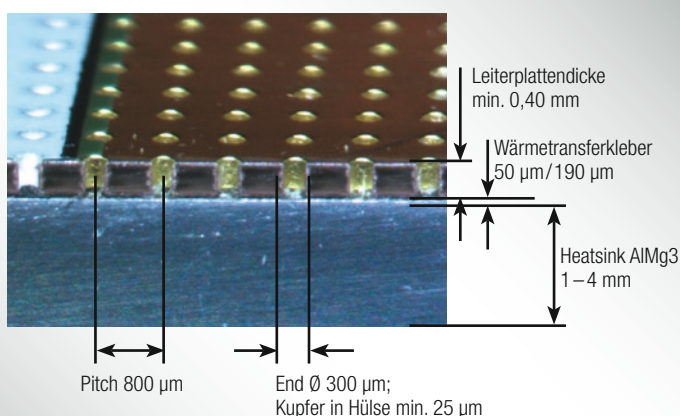
## Kombination Microvia, Buried Via als Thermovia



## Thermovias gefüllt (filled & capped via)



## Thermovias ungefüllt

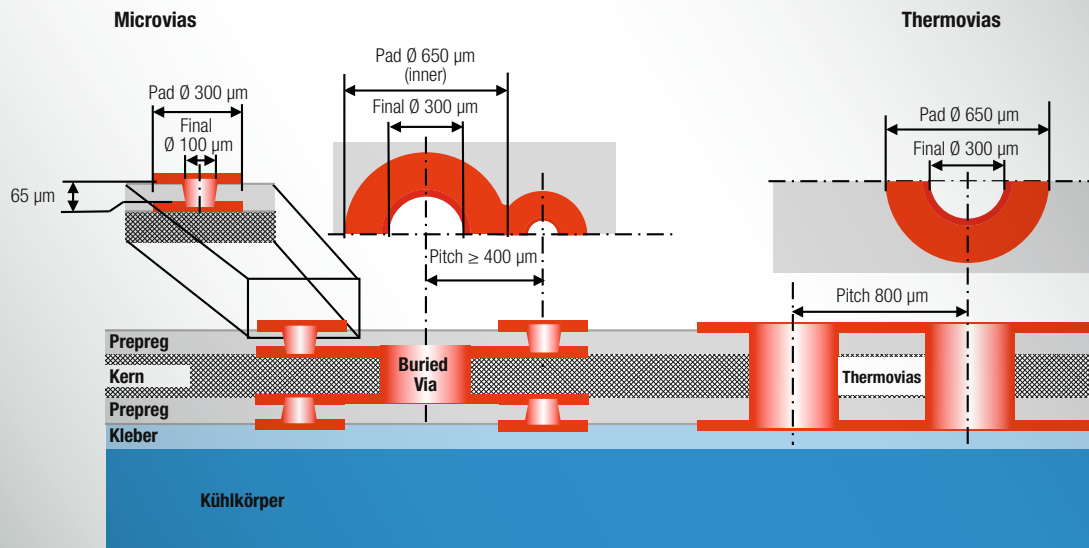


## DESIGN GUIDE

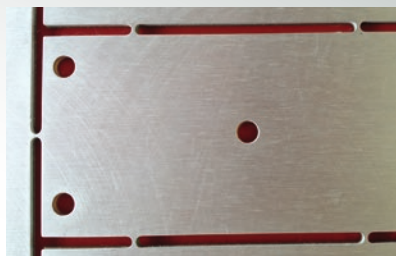
Version 1.0



## Standard Design Regeln

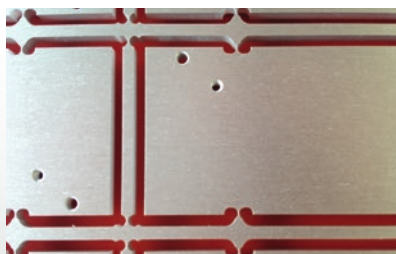


## Sollbruchstellen Kühlkörper



## Positive Sollbruchstellen

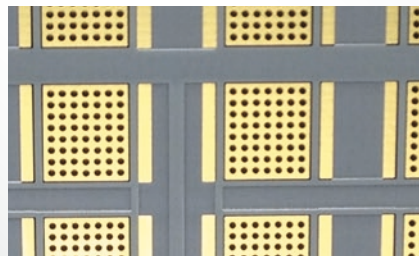
Bruchstelle befindet sich im Fräskanal außerhalb der Leiterplattenkontur.



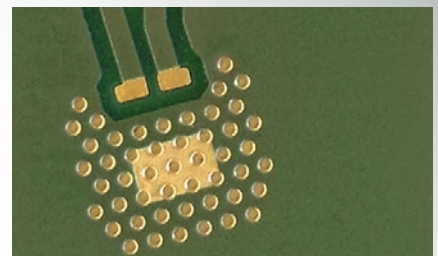
## Negative Sollbruchstellen

Bruchstelle innerhalb der Leiterplattenkontur. Zusätzliche Zwischenstege zur Stabilität des Nutzens benötigt.

## Designbeispiele



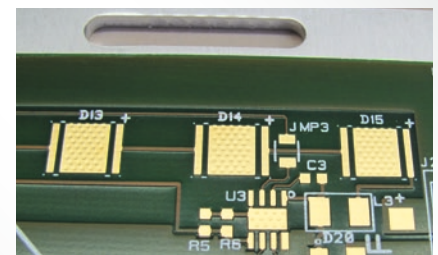
Thermovias im Pad



Thermovias im Pad und außerhalb



Ausbruch im Kühlkörper



Kühlkörper größer als Leiterplatte

Mehr Informationen zu Wärmemanagement von Leiterplatten finden Sie auf unserer Homepage:  
[www.we-online.de/heat](http://www.we-online.de/heat)